DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI (c) 1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007249169

WPI Acc No: 87-246176/198735 Related WPI Acc No: 83-40780K

XRAM Acc No: C87-104197 XRPX Acc No: N87-184002

Mfg. composite - includes chemical vapour deposition of carbon film on

metallic or ceramic substrate

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (SEME )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 62167885 A 19870724 JP 86277517 A 19860120 198735 B

JP 92027690 B 19920512 JP 81146930 A 19810917 H01L-021/205

199223 JP 86277517 A 19810917

Priority Applications (No Type Date): JP 86277517 A 19860120; JP 81146930 A 19810917

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

JP 62167885 A 3

JP 92027690 B 3 Div ex JP 81146930

Based on JP 62167885

Abstract (Basic): JP 62167885 A

A carbon film is coated on the surface of a metallic or ceramic substrate at low temp. of 150-450 deg.C by introducing a hydrocarbon gas of e.g. acetylene or methane to a plasma atmos. decomposing to form C-C bond.

The carbon film has diamond structure to protect the substrate from the effects of mechanical stress.

1/1

Title Terms: MANUFACTURE; COMPOSITE; CHEMICAL; VAPOUR; DEPOSIT;

CARBON; FILM; METALLIC; CERAMIC; SUBSTRATE

Derwent Class: E36; L02; M13; U11

International Patent Class (Main): H01L-021/205

International Patent Class (Additional): C23C-016/26; C30B-029/04;

H01L-021/20

File Segment: CPI; EPI

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公告

許 公 報(B2) ⑫特

 $\Psi 4 - 27690$ 

®Int. Cl. 5

識別記号

厅内整理番号

平成4年(1992)5月12日

H 01 L 21/205 C 30 B 29/04

7739 - 4MD 7158 - 4G

発明の数 2 (全3頁)

❷発明の名称 ダイヤモンド構造を有する炭素被膜の作製方法

判 平1-6553

②特 昭61-277517 顧

開 昭62-167885 多公

多出 昭56(1981)9月17日 至

❷昭62(1987)7月24日

願 昭56-146930の分割 ❷特

@発 明 者 Ш 蛤

舜 平 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー

研究所内

の出 類 人 株式会社 半導体エネ

神奈川県厚木市長谷398番地

ルギー研究所

四代 理 人

弁理士 鴨田 朝雄

審判の合議体 審判長 飛鳥井 春雄 審判官 木 梨 貞 男 審判官 山本 一正 醫参考文献

Solid State Communications Vol. 34 PP. 15-18

1

## 切特許請求の範囲

1 炭化水素気体と水素又はヘリユームの混合気 体とを反応系に導入し、IGIL以上の周波数のマ イクロ波及び0.1~50MHzの高周波の電磁エネル ギーを前配混合気体に供給してブラズマ化し、ダ 5 イヤモンド構造の結晶を有する炭素被膜を被膜形 成面上に形成することを特徴とする炭素被膜の作 製方法。

2 炭化水素気体がアセチレン又はメタンである 法。

3 炭化水素気体と水素又はヘリユームの混合気 体とⅢ価又はV価の不純物気体とを反応系に導入 し、IGHz以上のマイクロ波及び0.1~50MHzの高 プラズマ化し、P型又はN型のダイヤモンド構造 の結晶を有する炭素被膜を被膜形成面上に形成す ることを特徴とする炭素被膜の作製方法。

4 炭化物気体がアセチレン又はメタンである特 許請求の範囲第3項に記載の炭素被膜の作製方 20 ロゲン元素が25モル%以下の量を同時に含有して 法。

## 発明の詳細な説明

本発明は、プラズマCVD法によりダイヤモン ド構造を有する炭素被膜を作製する方法に関す 2

る。

本発明は、かかる炭素または炭素を主成分とす る被膜をガラス、金属またはセラミツクスの表面 にコーテイングすることにより、ガラス板の補強 材、また機械的ストレスに対する保護材を得んと している複合体の作製方法に関する。

本発明は、アセチレン、メタンのような炭化水 素気体をプラズマ雰囲気中に導入し分解せしめる ことにより、CーC結合を作り、結果としてグラ 特許請求の範囲第1項に記載の炭素被膜の作製方 10 ファイトのような導電性または不良導電性の炭素 を作るのではなく、光学的にエネルギバンド巾 (Egという) が20eV以上、好ましくは26~ 4.5eVを有する単結晶ダイヤモンドに類似のダイ ヤモンド構造を有する絶縁性の炭素を形成するこ 周波の電磁エネルギーを前記混合気体に供給して 15 とを特徴としている。さらにこの本発明の炭素 は、その硬度も4500kg/試以上、代表的には6500 kg/miというダイヤモンド類似の硬さを有する。 そしてその結晶学的構造は5~200Åの大きさの 微結晶性を有している。またこの炭素は水素、ハ いる。

> また本発明の炭素に豆価またはV価の不純物を 5モル%以下に添加し、PまたはN型の導電型を 有せしめ得る。

本発明は、この炭素を形成させる際の基板に加 える温度を150~450℃とし、従来より知られた CVD法において用いられる基板の温度に比べ500 ~1500°Cも低い温度で形成したことを他の特徴と する。

また本発明はこの炭素に重価の不純物であるホ ウ素を0.1~5モル%の濃度に添加し、P型の炭 素を設け、またV価の不純物であるリンを同様に 0.1~5モル%の農度に添加し、N型の炭素を設 イト構造とは異なる価電子制御による半導電性を 有せしめたことを他の特徴としている。

さらに本発明は、この基板上にPIN接合または NIP接合を有する炭素を設けることにより、ダイ とを特徴としている。

また本発明は基板特にガラスまたはセラミック を用い、その後この基板の一部を選択的に除去し てインクジェットノズル、光通信用石英ガラスの 引き出し用ノズルとして設けるものである。

また本発明は、ガラス基板上に選択的に炭素被 膜を設け、電子ピーム電光装置または紫外線の電 光装置のフォトマスクとして用いることを他の特 徴としている。

またはPIN型を有する半導体としての装置例えば 受光または発光素子への反応が可能である。

以下に図面に従つて本発明に用いられた複合体 またはその複合体の作製方法を記す。

## 実施例 1

第1図は本発明の炭素を形成するためのプラズ マCVD装置の概要を示す。

図面において反応性気体である炭化水素気体、 例えばアセチレンが8よりパルプ、流量計5をへ て反応系中の励起室4に導入される。さらに必要 35 きわめて優れているのが特徴である。 に応じて、キャリアガスを水素またはヘリユーム により7よりパルブ、流量計6をへて同様に励起 室に至る。ここに重価またはV価の不純物、例え ばジポランまたはフオスヒンを導入する場合はさ らに同様にこの系に加えればよい。

これらの反応性気体は2.45GHzのマイクロ波に よる電磁エネルギにより0.1~5Kwのエネルギを 加えられ、励起室にて活性化、分解または反応さ せられてC一C結合を生成した。さらにこの反応

性気体は反応炉1にて加熱炉9により150~450℃ に加熱させ、さらに13.56MHzの高周波エネルギ 2により反応、重合され、C一C結合を多数形成 した炭素を生成する。この際、加える高周波やマ イクロ波の電磁エネルギが小さい場合はアモルフ アス構造の炭素が生成される。このため本発明方 法ではこの電磁エネルギを強く加え、5~200 A の大きさのダイヤモンド形状の微結晶性を有する 炭素を生成させる。この反応は電源13によりヒ けることにより、この基板上面の炭素をグラフア 10 ータ11を加熱し、さらにその上の基板10を加 熱して行う。そしてこの基板の上面に被膜として 反応生成物の炭素被膜が形成される。反応後の不 要物は排気口12よりロータリーポンプを経て排 気される。反応室 1 は0.001~10torr代表的には オード特性を有する半導体的特性を有せしめるこ 15 0.1~0.5torrに保持されており、マイクロ波 3、 高周波2のエネルギにより反応室1内はプラズマ 状態が生成される。特に1GHz以上の周波数にあ つては、C一H結合より水素を分離し、0.1~ 50MHzの周波数にあつてはC≡C結合、C=C結 20 合を分解し、 > C - C く結合または - C - C - 結 合を作り、炭素の不対結合手同志を互いに衝突さ せて共有結合させ、安定なダイヤモンド構造を有 せしめた。

かくしてガラス、金属、セラミツクスよりなる さらに本発明の複合体はパルブ、耐磨耗材料、25 被形成面を有する基板上に炭素特に炭素中に水素 を25モル%以下含有する炭素またP、IまたはN 型の導電型を有する炭素を形成させた。

> 以上の説明より明らかな如く、本発明はガラ ス、金属またはセラミックスの表面または内部に 30 炭素または炭素を主成分とした被膜をコーテイン グして設けたものである。この複合体は他の多く の実施例にみられる如く、その応用は計り知れな いものであり、特にこの炭素が450℃以下の低温 で形成され、その硬度また基板に対する密着性が

> 本発明におけるセラミツクはアルミナ、ジルコ ニア、またはそれらに炭素またはランタン等の希 土類元素が添加された任意の材料を用いることが できる。また金属にあつては、ステンレス、モリ 40 ブテン、タングステン等の少なくとも300~450℃ の温度に耐えられる材料ならばすべてに応用可能 である。またガラスは石英のみならずソーダガラ ス等に対しても被膜化が可能であり、その応用は きわめて広い。

5

6

## 図面の簡単な説明

製造装置の概要を示す。

第1図は本発明の炭素を被形成面上に作製する

第1図

